



NXP, 무라타에 와이파이 6 모듈용 RF 프런트 엔드 IC 공급

*양사는 NXP의 프런트 엔드 IC(FEIC)와 무라타의 통합 기술을 결합해
와이파이 6용 소형 울트라 콤팩트 RF 모듈 제공*

2020년 4월 24일 - NXP 반도체는 5G 모바일 플랫폼용 패키지형 시스템(SiP) 통합 업체인 무라타(Murata)와 협력해, 최신 와이파이 6 표준으로 설계된 업계 최초 무선 주파수(RF) 프런트 엔드 모듈을 제공한다고 발표했다. 이번 협력을 통해, 양사는 차세대 와이파이 6을 구현할 때 설계 및 시장 출시 시간을 단축하고 보드 공간을 절약할 수 있는 솔루션을 제공한다.

NXP FEIC는 모듈 통합에 적합한 칩 스케일 패키지(CSP)로 패키징돼 있으며, 다양한 5G 스마트폰과 휴대용 컴퓨팅 장치를 지원한다. 또한 고성능 2x2 다중 입력 다중 출력(MIMO) 기능을 지원한다.

무라타의 R&D 매니저 카츠히코 후지카와(Katsuhiko Fujikawa)는 “무라타는 NXP와 협력하여 와이파이 6 플랫폼용 RF 프런트 엔드 모듈을 개발하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다. NXP의 모놀리식 프런트 엔드 IC는 와이파이 6 플랫폼을 선도하고 있으며 크기 및 통합 측면에서 완벽한 유연성을 제공한다. 우리는 NXP와 계속 협력하여 앞으로 새로운 스펙트럼과 표준을 지원하는 신규 모듈을 개발할 계획이라고 말했다.

NXP 무선주파수 사업부 수석부사장 겸 총괄 폴 하트(Paul Hart)는 “무라타와의 협력을 통해, 제조업체들이 5G 디바이스를 위한 고도로 통합되고 완전히 검증된, 자격을 갖춘 솔루션을 제공할 수 있도록 지원할 수 있게 됐다. 또한 빠르게 증가하는 와이파이 6에 대한 세계적인 수요에 발맞춰 가장 고성능이며 동시에 가장 작은 크기의 제품을 제공할 수 있다. 오늘날 업계의 그 어떤 반도체 제조업체도 이만큼 빠른 배포의 수요를 충족할 솔루션을 보유하고 있지 않다”고 말했다.

NXP의 WLAN11ax 포트폴리오 관련 정보

NXP의 고성능 WLAN11ax 포트폴리오는 더 많은 대역폭에 대한 증가하는 필요성을 충족시켜 와이파이 6 구현의 다음 단계를 가능하게 한다. 2.4 GHz와 802.11ax 와이파이 6 표준에 맞는 5 GHz 대역을 모두 제공함으로써 NXP는 이러한 사양을 뛰어넘는 유연한 포트폴리오를 제공한다.

NXP는 IEEE802.11a/n/ac/ax 애플리케이션에 2x2 MIMO 지원을 제공한다. NXP의 WLAN 포트폴리오에 대한 자세한 정보는 <https://www.nxp.com/products/rf/wlan-front-end-modules:WLAN-FRONTEND-MODULES> 에서 확인할 수 있다.



NXP 반도체 소개

NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 30,000명의 직원을 고용하고 있다. 2019년 매출은 미화88억 8천만불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (<http://blog.naver.com/nxpkor>) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.